

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):



BLACK BORDERS

- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 공개특허공보(A)

(51)○Int. Cl.	(11) 공개번호	특 1997-0072358
HO1L 23 /50	(43) 공개일자	1997년 11월 07일
(21) 출원번호	특 1996-0009774	
(22) 출원일자	1996년 04월 01일	
(71) 출원인	아닝산업 주식회사	황인길
(72) 발명자	서민규	서민규
(74) 대리인	경기도 성남시 분당구 수내동 55 롯데아파트 132-1504	
설명부 : 있음	서민규	
(54) 반도체패키지의 제조방법 및 구조		

요약

본 발명은 반도체패키지의 제조방법 및 구조에 관한 것으로, 반도체칩의 저연율 외부로 노출시켜 회로동작시 발생되는 열 방출의 효과를 극대화하여 패키지의 수명을 연장시키고, 신뢰성을 향상시킴은 물론 패키지의 물당부 외측에 위치한 리드는 절단하고, 물당부 내측에 위치한 리드는 그 저연율 외부로 노출시켜 미더보드에 실장시 리드의 저연에서 신호전달을 하도록 함으로서 실장면적을 최소할 수 있는 반도체패키지이다.

도면도

도2

설명서

[발명의 명칭]

반도체패키지의 제조방법 및 구조

[도면의 간단한 설명]

제2도는 본 발명에 적용되는 리드프레임을 도시한 평면도.

본 내용은 요부공개 건이므로 전문내용을 수록하지 않았음

(5/1) 청구의 범위

청구항 1. 다수의 리드가 형성되고, 상기 다수의 리드 중앙부에는 침립재판이 없는 리드프레임을 형성하는 단계와; 상기 리드프레임의 다수의 리드 중앙부에 반도체칩을 위치시켜 와이어본딩을 실시하는 단계와; 상기 와이어본딩된 리드, 반도체칩 및 와이어를 외부의 신화 및 부식으로부터 보호하기 위하여 울당하는 단계와; 상기 단계후에 울당영역 외각에 위치한 리드를 절단하는 단계로 이루어진 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.

청구항 2. 제1항에 있어서, 상기 와이어본딩은 배륨 흡(Vacuum Hole)이 형성된 히터블럭에 반도체칩을 위치시켜 상기 배륨 흡으로 공기를 밀어들여 반도체칩을 지지 고정하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.

청구항 3. 제1항에 있어서, 상기 울당단계는 액상 봉지재를 사용하여 울당하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.

청구항 4. 제1항 또는 3항에 있어서, 맥상 풍지재를 사용하여 울당하기 전에 울당영역에 담을 형성하여 액상 봉지재가 울려 넘치는 것을 방지하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.

청구항 5. 제1항에 있어서, 상기 울당단계는 물드 컴파운드를 사용하여 울당하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.

청구항 6. 제3항 또는 5항에 있어서, 상기 액상 봉지재 및 물드 컴파운드로 울당 후, 150°C 이상의 고온에서 수시간 노출시켜 경화시키는 공정을 포함하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.

청구항 7. 제1항에 있어서, 상기 반도체패키지의 저연에는 그라인드(Grind)를 실시하여 플래쉬(Flash)를 제거하는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.

청구항 8. 제1항에 있어서, 상기 울당영역의 외각에 위치한 리드를 절단시 절단을 용이하게 하기 위하여 절단되는 부위의 리드에 노치(Notch)를 형성함을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법.

청구항 9. 저연이 외부로 직접 노출되는 반도체칩과; 상기 반도체칩의 외측에 위치되고 울당영역을 벗어나지 않으며 저연이 외부로 노출되어 저연에서 신호의 입출력이 이루어지는 다수의 리드와; 상기 반도체칩과 리드를 연결시켜주는 와이어와; 상기 반도체칩, 리드 및 와이어를 외부 환경으로부터 보호하기 위하여 울당된 액상 봉지재 또는 컴파운드로 구성된 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 구조.

청구항 10. 제9항에 있어서, 상기 물당된 액상 봉지재 및 컴파운드는 리드 및 반도체칩의 상부로만 울당된 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 구조.

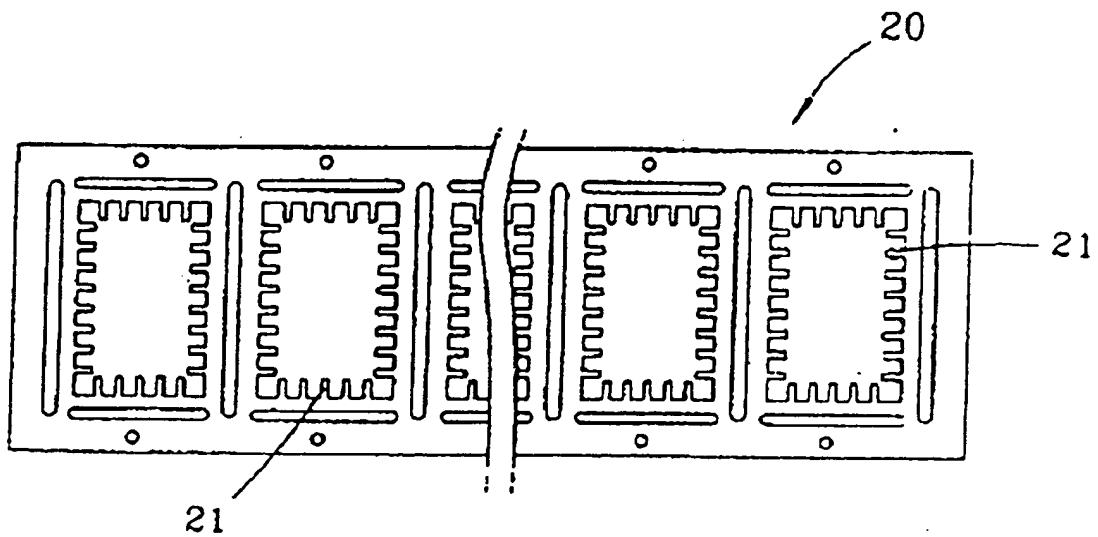
청구항 11. 제9항에 있어서, 상기 반도체패키지의 저연에는 플래쉬(Flash)의 제거를 위해 그라인드(Grind)된 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 구조.

청구항 12. 제9항에 있어서, 리드프레임의 다수의 리드 중앙부에는 침립재판이 없는 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 구조.

* 참고사항: 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.

581

582



공개특허 97-72358 1/2

① 대 한 민 국 특 허 청 (KR)
 ② 공 개 특 허 공 보 (A)

③ InL Cl.
 II 01 L 23/50

제 2658 호

④ 등록일자 1997. 11. 7
 ⑤ 출원일자 1996. 4. 1

⑥ 공개번호 97-72358

⑦ 출원번호 96- 9774

실사첨구 : 있음

⑧ 발 명 자 허 명 족 경기도 성남시 분당구 수내동 55 드레이프트 132- 1504

⑨ 출 원 인 아남산업 주식회사 대표이사 왕 인 선

서울특별시 송파구 성수 2가 280-8 (우: 133-120)

⑩ 대리인 법무사 서 만 규

(전 2면)

⑪ 반도체패키지의 제조방법 및 구조

⑫ 요 약

본 발명은 반도체패키지의 제조방법 및 구조에 관한 것으로 반도체칩의 저연을 외부로 노출시켜 회로통작식 발생되는 열단승의 효과를 극대화하여 패키지의 수명을 연장시키고, 신뢰성을 향상시킬은 물론, 패키지의 용평부 외측에 위치한 티드는 절단하고, 울돌부 내측에 위치한 티드는 그 저연을 외부로 노출시켜 마더보드에 상장시 티드의 저연에서 신호전달을 하도록 함으로서 신호연결을 빠르게 할 수 있는 반도체패키시이다.

특허청구의 범위

1. 리수의 리드가 형성되고, 상기 다수의 리드 중 일부에는 칠팅재판이 없는 리드프레임을 형성하는 단계와; 상기 리드프레임과 다수의 리드 중 일부에 반도체침을 위치시켜 와이어본딩을 실시하는 단계와; 상기 와이어본딩된 리드, 반도체침 및 와이어를 외부의 신호 및 부식으로부터 보호하기 위하여 물딩하는 단계와; 상기 단계 후에 물딩영역 외기에 위치한 리드를 절단하는 단계로 이루어진 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 제조방법.
2. 제1항에 있어서, 상기 와이어본딩은 배풀 홀(Naupush Hole)이 형성된 허디플렉에 반도체침을 위치시켜 상기 배풀 홀로 공기를 밀어들여 반도체침을 치자 고정하는 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 제조방법.
3. 제1항에 있어서, 상기 물딩단자는 액상 물지재를 사용하여 물딩하는 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 제조방법.
4. 제1항 또는 3항에 있어서, 액상 물지재를 사용하여 물딩하기 전에 물딩영역에 단을 형성하여 액상 물지재가 끈적 끈적하는 것을 방지하는 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 제조방법.
5. 제1항에 있어서, 상기 물딩단자는 물드 침파운드를 사용하여 물딩하는 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 제조방법.
6. 제3항 또는 5항에 있어서, 상기 액상 물지재 및 물드 침파운드로 물딩 후, 150°C 이상의 고온에서 수시진 노출시켜 경화시키는 금정을 포함하는 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 제조방법.
7. 제1항에 있어서, 상기 반도체제작기지의 저연에는 그라인드(Grind)를 실시하여 플래시(Flash)를 제거하는 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 제조방법.
8. 제1항에 있어서, 상기 물딩영역의 외각에 위치한 리드를 절단시 절단을 용이하게 하기 위하여 절단되는 부위의 리드에 노치(Notch)를 형성한은 특징으로 하는 반도체제작기지의 제조방법.
9. 저연이 외부로 직접 노출되는 반도체침과; 상기 반도체침의 외측에 위치되고 물딩영역을 벗어나지 않으며 저연이 외부로 노출되어 저연에서 신호의 입출력이 이루어지는 다수의 리드와; 상기 반도체침과 리드를 연결시켜주는 와이어와; 상기 반도체침, 리드 및 와이어를 외부 환경으로부터 보호하기 위하여 물딩된 액상 물지재 또는 침파운드로 구성된 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 구조.
10. 제9항에 있어서, 상기 물딩된 액상 물지재 및 침파운드는 리드 및 반도체침의 상부로만 물딩된 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 구조.
11. 제9항에 있어서, 상기 반도체제작기지의 저연에는 플래시(Flash)의 제거용 러시 그라인드(Grind)된 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 구조.
12. 제9항에 있어서, 리드프레임의 다수의 리드 중 일부에는 칠팅재판이 없는 것을 특징으로 하는 반도체제작기지의 구조.

※ 참고사항: 저조준원 내용에 의하여 공개하는 것임.
도면의 간단한 설명

제2도는 본 발명에 적용되는 리드프레임을 도시한 평면도.

제 2 도

